

# 典型 RoHS 回流焊曲線

- ▶ 所有德鍵電子符合 RoHS 標準的元器件，可向後兼容錫鉛焊接工藝。焊接溫度必須大於 230° C 以確保無鉛焊錫適當的熔融。

對於所有焊接方法，優化回流曲線的電路板組裝，取決於焊接材料，焊料量，流量，每個焊接元件組成部分的溫度限制，傳熱特性的電路板，元器件材料，和所有組成元器件的佈局。溫度與時間的限制可以電路板組裝中最不耐溫的組件為最終確定實際必須使用的溫度曲線。由於這些原因，令牌不指定焊接型材為我們的組件。

這是典型的回流曲線基於 IPC/JEDEC J-STD-020 修訂於（2008 年 3 月）。它僅僅作為一個指導參考。

有關詳細信息，及最新資訊，請參閱以下網站：[www.jedec.org](http://www.jedec.org).

